WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶:

H01L 21/48, 23/13

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 99/10926

A1

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

4. März 1999 (04.03.99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP98/05251

(22) Internationales Anmeldedatum: 18. August 1998 (18.08.98)

(30) Prioritätsdaten:

197 36 654.6

22. August 1997 (22.08.97)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS S.A. [BE/BE]; Chaussée de Charleroi 116, B-1060 Bruxelles (BE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HEERMAN, Marcel [BE/BE]; Azalea-Strasse 6, B-9200 Merelbeke (BE). VAN PUYMBROECK, Jozef [BE/BE]; Korenbloemstraat 17, B-8020 Oostkamp (BE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS S.A.; Epping, Wilhelm, Postfach 22 13 17, D-80503 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: CN, JP, KR, SG, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

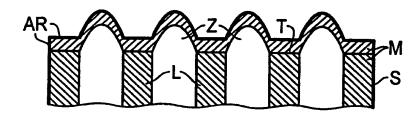
Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING ELECTRICALLY CONDUCTIVE CROSS CONNECTIONS BETWEEN TWO LAYERS OF WIRING ON A SUBSTRATE

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON ELEKTRISCH LEITENDEN QUERVERBINDUNGEN ZWISCHEN ZWEI VERDRAHTUNGSLAGEN AUF EINEM SUBSTRAT

(57) Abstract

According to the invention, teeth (Z) are incorporated into a three-dimensional, injection-moulded substrate (S) during the injection moulding process, said teeth being located in the outer edge area and/or in the area of a recess. A metallic coating (M) is then applied to the substrate (S). Extremely finely structured electrically



conductive cross connections are produced when said metal coating (M) is removed in the area of the teeth (Z), especially after the teeth (Z) have been ground down or cut off.

(57) Zusammenfassung

Bei einem dreidimensionalen, spritzgegossenen Substrat (S) werden beim Spritzgießvorgang im äußeren Randbereich und/oder im Bereich einer Aussparung Zähne (Z) mitgeformt. Nach dem Aufbringen einer Metallisierung (M) auf das Substrat (S) entstehen durch Entfernung der Metallisierung (M) im Zahnbereich, insbesondere nach Abschleifen oder Abschneiden der Zähne (Z), elektrisch leitende Ouerverbindungen mit sehr hoher Strukturfeinheit.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
ΑZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Paso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungam	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	zw	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	L	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

Beschreibung

Verfahren zur Herstellung von elektrisch leitenden Querverbindungen zwischen zwei Verdrahtungslagen auf einem Substrat

5

10

15

20

Integrierte Schaltkreise bekommen immer höhere Anschlußzahlen und werden dabei immer weiter miniaturisiert. Die bei dieser zunehmenden Miniaturisierung erwarteten Schwierigkeiten mit Lotpastenauftrag und Bestückung sollen durch neue Gehäuseformen behoben werden, wobei hier insbesondere Single-, Fewoder Multi-Chip-Module im Ball Grid Array Package hervorzuheben sind (DE-Z productronic 5, 1994, Seiten 54, 55). Diese Module basieren auf einem durchkontaktierten Substrat, auf welchem die Chips beispielsweise über Kontaktierdrähte oder mittels Flipchip-Montage kontaktiert sind. An der Unterseite des Substrats befindet sich das Ball Grid Array (BGA), das häufig auch als Solder Grid Array, Land Grid Array oder Solder Bump Array bezeichnet wird. Das Ball Grid Array umfaßt auf der Unterseite des Substrats flächig angeordnete Lothökker, die eine Oberflächenmontage auf den Leiterplatten oder Baugruppen ermöglichen. Durch die flächige Anordnung der Lothöcker können hohe Anschlußzahlen in einem groben Raster von beispielsweise 1,27 mm realisiert werden.

25 Bei der sog. MID-Technologie (MID = Moulded Interconnection Devices) werden anstelle konventioneller gedruckter Schaltungen Spritzgießteile mit integrierten Leiterzügen verwendet. Hochwertige Thermoplaste, die sich zum Spritzgießen von dreidimensionalen Substraten eignen, sind die Basis dieser Tech-30 nologie. Derartige Thermoplaste zeichnen sich gegenüber herkömmlichen Substratmaterialien für gedruckte Schaltungen durch bessere mechanische, chemische, elektrische und umwelttechnische Eigenschaften aus. Bei einer speziellen Richtung der MID-Technologie, der sog. SIL-Technik (SIL = Spitzgieß-35 teile mit integrierten Leiterzügen), erfolgt die Strukturierung einer auf die Spritzgießteile aufgebrachten Metallschicht unter Verzicht auf die sonst übliche Maskentechnik

2

durch ein spezielles Laserstrukturierungsverfahren. In die dreidimensionalen Spritzgießteile mit strukturierter Metallisierung sind dabei mehrere mechanische und elektrische Funktionen integrierbar. Die Gehäuseträgerfunktion übernimmt gleichzeitig Führungen und Schnappverbindungen, während die Metallisierungsschicht neben der Verdrahtungs- und Verbindungsfunktion auch als elektromagnetische Abschirmung dient und für eine gute Wärmeabfuhr sorgt. Zur Herstellung von elektrisch leitenden Querverbindungen zwischen zwei Verdrah-10 tungsanlagen auf einander gegenüberliegenden Oberflächen der Spritzgußteile werden bereits beim Spritzgießen entsprechende Durchkontaktierungslöcher erzeugt. Die Innenwandungen dieser Durchkontaktierungslöcher werden dann beim Metallisieren der Spritzgießteile ebenfalls mit einer Metallschicht überzogen. 15 Weitere Einzelheiten zur Herstellung von dreidimensionalen Spritzgießteilen mit integrierten Leiterzügen gehen beispielsweise aus der DE-A-37 32 249 oder der DE-A-0 361 192 hervor.

20 Gemäß einer aus der EP-A-0 645 953 bekannten Variante der MID-Technologie werden auf einem durch Spritzgießen hergestellten und mit einer Mulde versehenen Substrat nacheinander eine erste Leiterebene, eine Dielektrikumschicht und eine zweite Leiterebene erzeugt, worauf in die Mulde ein elektro-25 nisches Bauelement eingebracht wird, die Anschlüsse des Bauelements mit zugeordneten Anschlußflächen auf dem Substrat vorzugsweise durch Bonden elektrisch leitend verbunden werden und dann durch Füllen der Mulde mit Kunststoff eine Verkapselung für das Bauelement gebildet wird. Es entsteht ein kom-30 pakter, dünner Aufbau mit einer hohen Verdrahtungsdichte. Durch die versunkene Montage und Verkapselung von Bauelementen in Mulden des spritzgegossenen Substrats wird neben der Dickenreduzierung ein optimaler Schutz von Bauelement und dessen Anschlußverdrahtung erzielt.

35

Aus der WO-A-96 096 46 ist ein sog. Polymer Stud Grid Array (PSGA) bekannt, welches die Vorteile eines Ball Grid Arrays

3

(BGA) mit den Vorteilen der MID-Technologie vereinigt. Die Bezeichnung der neuen Bauform als Polymer Stud Grid Array (PSGA) erfolgte dabei in Anlehnung an das Ball Grid Array (BGA), wobei der Begriff "Polymer Stud" auf beim Spritzgießen des Substrats mitgeformte Polymerhöcker hinweisen soll. Die neue für Single-, Few- oder Multi-Chip-Module geeignete Bauform umfaßt

- ein spritzgegossenes, dreidimensionales Substrat aus einem elektrisch isolierenden Polymer,
- auf der Unterseite des Substrats flächig angeordnete und beim Spritzgießen mitgeformte Polymerhöcker,
 - auf den Polymerhöckern durch eine lötbare Endoberfläche gebildete Außenanschlüsse,
- zumindest auf der Unterseite des Substrats ausgebildete
 Leiterzüge, die die Außenanschlüsse mit Innenanschlüssen verbinden, und
 - mindestens einen auf dem Substrat angeordneten Chip, dessen Anschlüsse mit den Innenanschlüssen elektrisch leitend verbunden sind.

20

25

30

35

Neben der einfachen und kostengünstigen Herstellung der Polymerhöcker beim Spritzgießen des Substrats kann auch die Herstellung der Außenanschlüsse auf den Polymerhöckern mit minimalem Aufwand zusammen mit der bei der MID-Technologie bzw. der SIL-Technik üblichen Herstellung der Leiterzüge vorgenommen werden. Durch die bei der SIL-Technik bevorzugte Laserfeinstrukturierung können die Außenanschlüsse auf den Polymerhöckern mit hohen Anschlußzahlen in einem sehr feinen Raster realisiert werden. Hervorzuheben ist ferner, daß die Temperaturausdehnung der Polymerhöcker den Temperaturausdehnungen des Substrats und der das Modul aufnehmenden Leiterplatte entspricht. Sollten mechanische Spannungen auftreten, so ermöglichen die Polymerhöcker durch ihre elastischen Eigenschaften zumindest einen teilweisen Ausgleich. Durch die Formstabilität der auf den Polymerhöckern gebildeten Außenanschlüsse kann auch die Sicherheit bei Reparatur und Austausch gegenüber den Ball Grid Arrays mit ihren durch Lothöcker ge-

bildeten Anschlüssen erheblich gesteigert werden. Bei dem Polymer Stud Grid Array sind die Polymerhöcker und der Chip oder die Chips üblicherweise auf der gleichen Seite des Substrats angeordnet. Bei einem mit Durchkontaktierungen versehenen Substrat können die Polymerhöcker und der Chip oder die Chips durchaus auch auf verschiedenen Seiten des Substrats angeordnet sein. Eine derartige Anordnung von Polymerhöckern und Chips auf gegenüberliegenden Seiten des Substrats ist insbesondere bei großen Chips, die eine Vielzahl von zugeordneten Außenanschlüssen benötigen, interessant.

5

10

25

30

Aus der WO-A-89 00346 sind für die Oberflächenmontage geeignete Single-Chip-Module bekannt, die auf einem spritzgegossenen dreidimensionalen Substrat mit Durchkontaktierungslöchern 15 basieren. Neben diesen Durchkontaktierungslöchern erhält das Substrat beim Spritzgießen eine zentral auf der Oberseite angeordnete Mulde und eine Vielzahl von in ein oder auch in zwei peripheren Reihen auf der Unterseite angeordneten Poly-20 merhöckern. Der auf der Oberseite in der Mulde angeordnete Chip wird über feine Kontaktierdrähte mit zugeordneten, streifenförmig nach außen führenden Leiterbahnen verbunden. Diese Leiterbahnen sind dann über im äußeren Bereich angeordneten Durchkontaktierungen mit den zugeordneten, oberflächlich metallisierten Polymerhöckern elektrisch leitend verbunden. Werden dann die Randbereiche des Substrats mit mittig durch die Durchkontaktierungslöcher gehenden Schnittlinien abgetrennt, so entstehen elektrisch leitende Querverbindungen mit halbrundem Querschnitt, welche die äußeren Enden der auf der Oberfläche des Substrats angeordneten Leiterbahnen mit den zugeordneten auf der Unterseite des Substrats angeordneten Polymerhöckern elektrisch leitend verbinden.

Der im Anspruch 1 angegebenen Erfindung liegt das Problem zugrunde, bei der MID-Technologie die Herstellung von elek-35 trisch leitenden Querverbindungen zwischen zwei Verdrahtungslagen auf der Oberseite und der Unterseite eines spritzgegos-

5

senen Substrats zu vereinfachen. Die Querverbindungen sollen dabei insbesondere auch für die vorstehend erläuterten Polymer Stud Grid Arrays geeignet sein.

Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen insbesondere darin, daß gegenüber der konventionellen Durchkontaktierungstechnik mit metallisierten Löchern wesentlich feinere Strukturen mit einer höheren Zuverlässigkeit der Querverbindungen realisiert werden können. Die nach außen offene Verzahnung der Substrate kann im Gegensatz zu den Innenwandungen enger Durchkontaktierungslöcher mit einer sehr guten Schichtdickenverteilung metallisiert werden. Die Strukturierung der Metallisierung in die einzelnen Querverbindungen durch zumindest teilweise Entfernung der Metallisierung im Bereich der Zähne erfordert dabei nur einen geringen Aufwand.

Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Verfahrens sind in den Ansprüchen 2 bis 9 angegeben. Eine besonders vorteilhafte Anwendung des Verfahrens ist im Anspruch 10 angegeben.

Die Weiterbildung nach Anspruch 2 ermöglicht eine besonders feine Strukturierung der Zähne bei Spritzgießen.

Die Ausgestaltung nach Anspruch 3 ermöglicht die Anwendung der erfindungsgemäßen Querverbindungen bei Polymer Stud Grid Arrays. Hervorzuheben ist dabei, daß die Zähne und die Polymerhöcker bzw. Polymerstuds im gleichen Arbeitsgang beim Spritzgießen erzeugt werden.

30

20

Die Ausgestaltung nach Anspruch 4 hat den Vorteil, daß beim Aufbringen der Metallisierung auf Technologien zurückgegriffen werden kann, die sich bei der Herstellung gedruckter Schaltungen seit langer Zeit bewährt haben.

35

Obwohl das erfindungsgemäße Verfahren prinzipiell auch in Semiadditivtechnik durchgeführt werden kann, bietet die Sub-

traktivtechnik gemäß Anspruch 5 etliche Vorteile. Neben der einfachen und wirtschaftlichen Erzeugung der gewünschten Leitermuster ist hier insbesondere die Möglichkeit der Laserfeinstrukturierung hervorzuheben, die unter Verzicht auf die aufwendige konventionelle Photolithographie auch bei dreidimensionalen Substraten die Erzeugung feinster Strukturen ermöglicht. Gemäß Anspruch 6 kann die Ätzresistschicht hierbei auf einfache Weise durch die galvanische Abscheidung von Zinn oder Zinn-Blei aufgebracht und anschließend durch Bearbeitung mit dem Laserstrahl strukturiert werden.

Die Weiterbildung nach Anspruch 7 ermöglicht eine besonders einfache und zuverlässige mechanische Strukturierung der Metallisierung zur Erzeugung der Querverbindungen. Insbesondere kann diese mechanische Strukturierung im Bereich der Stirnseiten der Substrate gemäß Anspruch 8 durch Abschleifen oder, gemäß Anspruch 9, durch Abschneiden der Zähne besonders rasch und einfach durchgeführt werden.

10

- Gemäß Anspruch 10 ist das erfindungsgemäße Verfahren insbesondere für die Herstellung eines Polymer Stud Grid Arrays mit einem auf der Oberseite des Substrats angeordneten Chip geeignet. Durch die Anordnung des Chips auf der Oberseite und durch die Anordnung der Höcker bzw. Polymer Studs auf der Unterseite des Substrats ergeben sich hier ideale Voraussetzungen für die Realisierung von sog. Chip Scale Packages, bei welchen die Abmessungen des Arrays im wesentlichen den Abmessungen des Chips entsprechen.
- 30 Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird im folgenden näher beschrieben. Es zeigen
 - Figur 1 eine teilweise Draufsicht auf ein Substrat mit integral angeformten Zähnen im äußeren stirnseitigen Bereich,
 - Figur 2 eine dreidimensionale Darstellung der Zähne gemäß Figur 1,

WO 99/10926

5

10

7

PCT/EP98/05251

- Figur 3 eine teilweise Draufsicht auf ein Substrat mit integral angeformten Zähnen im Bereich einer Aussparung des Substrats,
- Figur 4 die teilweise Draufsicht auf das Substrat gemäß Figur 1 nach dem Auftragen einer Metallisierung und eines Ätzresists,
 - Figur 5 die teilweise Draufsicht auf ein Substrat gemäß Figur 4 nach der Laserstrukturierung,
- Figur 6 eine teilweise Draufsicht auf das Substrat gemäß

 Figur 4 nach dem Abschleifen der Zähne zur Bildung

 von Querverbindungen und
 - Figur 7 eine Seitenansicht des als Polymer Stud Grid Arrays ausgebildeten Substrats.
- 15 Gemäß Figur 1 wird von einem Substrat S ausgegangen, welches im äußeren stirnseitigen Bereich eine Vielzahl von im gleichmäßigen Abstand zueinander angeordneten Zähnen Z aufweist. Die Herstellung des Substrats einschließlich der Zähne Z und den später noch anhand der Figur 7 zu erläuternden Höcker H 20 erfolgt durch Spritzgießen, wobei als Substratmaterialien hochtemperaturbeständige Thermoplaste wie Polyetherimid, Polyethersulfon oder Polyamid geeignet sind. Die dreidimensionale Darstellung gemäß Figur 2 zeigt, daß die Zähne Z in Form eines Wellenprofils mit ebener Grundfläche ausgebildet sind 25 und sich zwischen der Oberseite O und der Unterseite U des Substrats S erstrecken. Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind Oberseite O und Unterseite U parallel zueinander ausgebildet, d.h. sämtliche Zähne Z, die selbstverständlich auch an die anderen drei Stirnseiten des Substrats S integral angeformt sein können, sind gleichlang. Figur 3 zeigt, daß die 30 Zähne Z prinzipiell auch im Bereich einer Aussparung A des Substrats S integral an die Stirnflächen der Aussparung A angeformt sein können. Neben der hier dargestellten rechteckförmigen Aussparung A können auch andere Formen, wie z.B. 35 kreisrunde Formen oder langlochartige Formen geeignet sein.

8

Das durch Spritzgießen hergestellte Substrat S wird zunächst einer Reihe von üblichen Vorbehandlungen unterzogen, insbesondere Beizen, Reinigen, Bekeimen und Aktivieren der Bekeimung. Anschließend wird gemäß Figur 4 durch außenstromlose chemische Kupferabscheidung und nachfolgende galvanische Kupferabscheidung eine Metallisierung M ganzflächig auf das Substrat S aufgebracht. Danach wird durch stromlose oder auch durch galvanische Abscheidung von Zinn ein Ätzresist AR auf die Metallisierung M aufgebracht. Da in Figur 4 nur der hier interessante stirnseitige Bereich des Substrats mit Zähnen Z dargestellt ist, muß darauf hingewiesen werden, daß sowohl die Metallisierung M als auch das Ätzresist AR das gesamte Substrat S ganzflächig überziehen.

Nach dem Aufbringen des Ätzresists AR erfolgt gemäß Figur 5 15 die Strukturierung der Metallisierung M auf der Oberseite O und der Unterseite U (vergleiche Figur 2) des Substrats S. Im hier dargestellten Ausführungsbeispiel wird in sämtlichen Bereichen, die nicht dem gewünschten Leitermuster der zu bil-20 denden Verdrahtungslagen entsprechen, das Ätzresist AR mittels Laserstrahlung wieder entfernt. Weitere Einzelheiten einer derartigen Laserstrukturierung gehen beispielsweise aus der DE-A-37 32 249 hervor. Anschließend werden die nicht geschützten Bereiche der Metallisierung M durch Ätzen bis zur 25 Oberfläche des Substrats S abgetragen. Aus Figur 5 ist ersichtlich, daß mit diesem Strukturierungsvorgang auf beiden Seiten des Substrats S Leiterbahnen L entstehen, die sich jeweils im Bereich zwischen zwei Zähnen Z zum Rand des Substrats S hin erstrecken. Die in Figur 5 dargestellte Trennlinie T dient nur zur Unterscheidung der oberflächlichen 30 Metallisierung M mit den Leiterbahnen L und der stirnseitigen Metallisierung M. Tatsächlich erstreckt sich die Metallisierung M jedoch ohne jegliche Trennung über das Substrat S.

Nach der geschilderten Bildung der Verdrahtungslagen auf Oberseite O und Unterseite U (vergleiche Figur 2) des Substrats S werden die Zähne Z durch Schleifen oder auch

9

durch Schneiden abgetragen. Gemäß Figur 6 entstehen hierdurch im stirnseitigen Bereich der früheren Zahnlücken elektrisch voneinander isolierte Querverbindungen Q.

5 Figur 7 zeigt eine Seitenansicht des Substrats S mit Leiterbahnen L, Querverbindungen Q und mit den bereits erwähnten Höckern H, die auf der Unterseite U flächig angeordnet sind. Auf die Oberseite O des Substrats S ist ein Chip C aufgebracht, dessen Kontaktierung entweder in der links dargestellten Wire-Bond-Technik mit Bonddrähten B oder in der rechts dargestellten Flip-Chip-Technik mit Anschlüssen A erfolgt. Bei der Wire-Bond-Technik ist der Chip C über eine Klebschicht K mit der Oberseite O des Substrats S verbunden.

Figur 7 zeigt deutlich, daß die einzelnen Anschlüsse des Chips C über Leiterbahnen L auf der Oberseite O, über stirnseitige Querverbindungen Q und über Leiterbahnen L auf der Unterseite U mit zugeordneten Höckern H elektrisch leitend verbunden sind. Auf die Unterseite der metallisierten Höcker H ist eine lötbare Endoberfläche E aufgebracht, die beispielsweise durch eine Schichtenfolge von Nickel und Gold gebildet wird.

Bei dem in Figur 7 dargestellten Gebilde handelt es sich um ein Polymer Stud Grid Array, das insgesamt mit PSGA bezeichnet ist. Weitere Einzelheiten derartiger Polymer Stud Grid Arrays gehen beispielsweise aus der WO-A-96 09646 hervor.

25

30

35

Bei dem in Figur 7 dargestellten Polymer Stud Grid Arrays PSGA sind die Außenabmessungen von Chip C und Substrat S etwa gleich groß. Es handelt sich somit um eine Gehäuseform, die üblicherweise als Chip Scale Package bezeichnet wird. Es ist auch klar zu erkennen, daß die stirnseitigen Querverbindungen Q mit ihrer hohen Strukturfeinheit eine äußerst kompakte Ausgestaltung des gesamten Polymer Stud Grid Arrays PSGA ermöglichen und damit einen entscheidenden Anteil an der Realisierung des Chip Scale Package haben.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von elektrisch leitenden Quer-

10

- verbindungen (Q) zwischen zwei Verdrahtungslagen auf der Oberseite (O) und der Unterseite (U) eines Substrats (S), mit folgenden Schritten:
 - a) Herstellung des Substrats (S) aus einem elektrisch isolierenden Kunststoff durch Spritzgießen, wobei im äußeren
 stirnseitigen Bereich des Substrats (S) und/oder im Bereich einer Aussparung (A) des Substrats (S) mehrere im
 Abstand zueinander angeordnete, sich zwischen Oberseite
 (O) und Unterseite (U) erstreckende, integrale Zähne (Z)
 beim Spritzgießen mitgeformt werden;
 - b) Aufbringen einer Metallisierung (M) auf das Substrat (S);
- c) Entfernen der Metallisierung (M) zumindest in den an das gewünschte Leitermuster angrenzenden Bereichen und im stirnseitigen Bereich der Zähne (Z), derart, daß zwischen den Zähnen (Z) elektrisch voneinander isolierte Querverbindungen (Q) entstehen.

20

35

- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß im Schritt a) beim Spritzgießen des Substrats (S) Zähne (Z) nach Art eines Wellenprofils geformt werden.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-zeichnet, daß im Schritt a) beim Spritzgießen des Substrats (S) auf dessen Unterseite (U) flächig angeordnete Polymerhöcker (H) mitgeformt werden und daß nach dem Aufbringen der Metallisierung (M) eine lötbare Endoberfläche (E) auf die Polymerhöcker (H) aufgebracht wird.
 - 4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallisierung (M) durch stromlose und galvanische Abscheidung von Kupfer auf das Substrat (S) aufgebracht wird.

11

- 5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß nach dem Schritt b) ein
 Ätzresist (AR) auf die Metallisierung aufgebracht wird, daß
 das Ätzresist (AR) zumindest in den an das gewünschte Leitermuster angrenzenden Bereichen mittels Laserstrahlung wieder
 entfernt wird und daß dann die freiliegenden Bereiche der Metallisierung (M) bis zur Oberfläche des Substrats (S) abgeätzt wird.
- 10 6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Ätzresist (AR) durch galvanische Abscheidung von Zinn oder Zinn-Blei aufgebracht wird.
- 7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-15 durch gekennzeichnet, daß die Metallisierung (M) im stirnseitigen Bereich der Zähne (Z) mechanisch entfernt wird.
 - 8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallisierung (M) im stirnseitigen Bereich der Zähne (Z) durch Abschleifen der Zähne (Z) entfernt wird.
 - 9. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallisierung (M) im stirnseitigen Bereich der Zähne (Z) durch Abschneiden der Zähne (Z) entfernt wird.

10. Anwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 3 bis 9, bei der Herstellung eines Polymer Stud Grid Arrays (PSGA) mit einem auf der Oberseite des Substrats (S) in Wire-Bond-Technik oder in Flip-Chip-Technik angeordneten Chip.

30

25



FIG 1

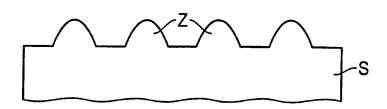


FIG 2

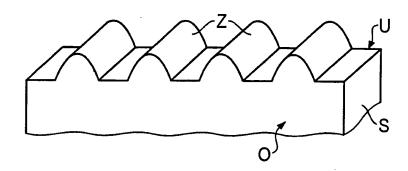
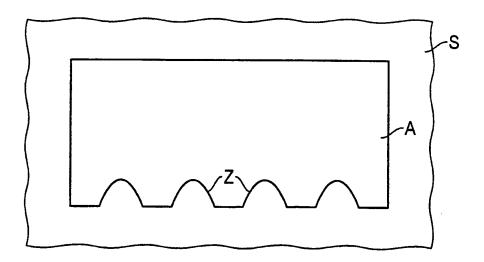
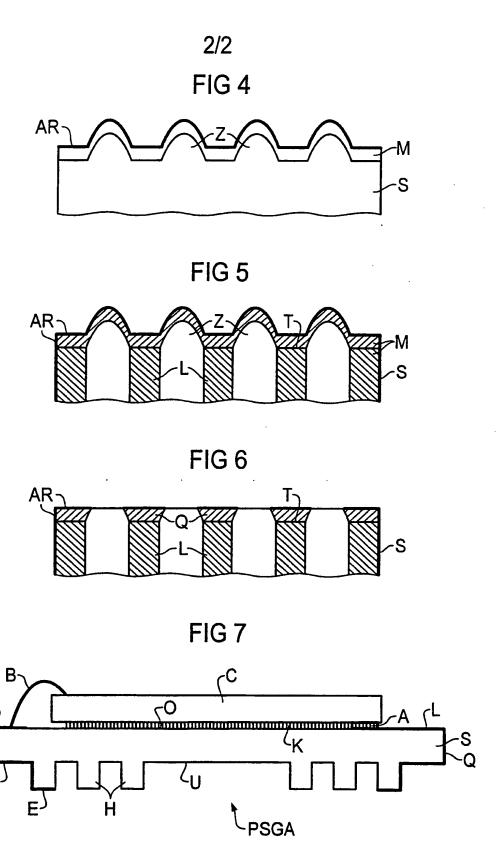


FIG 3





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In ational Application No PCT/FP 98/05251

			101/11 30	7 03231				
A. CLASSI IPC 6	FICATION OF SUBJECT MATTER H01L21/48 H01L23/13							
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific	ation and IPC						
	SEARCHED							
Minimum do IPC 6	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)							
	tion searched other than minimum documentation to the extent that s							
Electronic o	ata base consulted during the international search (name of data ba	se and, where practical,	search terms used)				
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	- .						
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rela	evant passages		Relevant to daim No.				
Y	"Method of making multilayer pac stamping and laser ablation" IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN vol. 33, no. 4, September 1990, p 405-406, XP002090043	l,		. 1				
Α	new york see the whole document			5				
Y	BENDER D K ET AL: "HIGHER DENSIT DIFFUSION PATTERNED VIAS AND FINE PRINTING" IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS, AND MANUFACTURING TECHNOLOGY: PAR vol. 17, no. 3, 1 September 1994, 485-489, XP000462350 see figure 3	E-LINE PACKAGING RT A,		1				
X Furth	ner documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family π	nembers are listed	in annex.				
"A" documer conside "E" earlier difiling de "L" documer which is citation "O" documer other n" "P" documer later the	ant defining the general state of the ant which is not sered to be of particular relevance locument but published on or after the international attemption of the state of the state of the stabilish the publication date of another or other special reason (as specified) with referring to an oral disclosure, use, exhibition or nears on the state of the stat	"Y" document of particular cannot be considered document is combined."	not in conflict with the principle or the car nelevance; the cad novel or cannot step when the doc ar relevance; the cad to involve an intend with one or monation being obvious the same patent the international sea	the application but sory underlying the laimed invention be considered to current is taken alone laimed invention rentive step when the re other such docu- is to a person skilled				
	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Authorized officer						
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	De Raeve	, R					

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ir ational Application No
PCT/EP 98/05251

	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	To the second second
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 96 09646 A (SIEMENS NV ;IMEC INTER UNI MICRO ELECTR (BE); HEERMAN MARCEL (BE);) 28 March 1996 cited in the application see figure 1	10
A	US 5 196 089 A (KAMBE ROKURO ET AL) 23 March 1993 see figures 8-10	1
A	US 3 483 308 A (WAKELY WILBUR T) 9 December 1969 see figures 1,3	10
ì		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

ir .ational Application No PCT/EP 98/05251

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date	
WO 9609646 A	28-03-1996	EP 0782765 A JP 9511873 T	09-07-1997 25-11-1997	
US 5196089 A	23-03-1993	JP 5013960 A	22-01-1993	
US 3483308 A	09-12-1969	DE 1952569 A FR 2021493 A GB 1263126 A NL 6915455 A	06-05-1970 24-07-1970 09-02-1972 28-04-1970	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Im .tlonales Aktenzeichen PCT/EP 98/05251

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 6 H01L21/48 H01L23/13						
Nach dar in	iternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla	sesifikation und der IPK				
	RCHIERTE GEBIETE	SSILKELION UND UND IN IN				
Recherchie	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo	ole)				
IPK 6	HO1L					
=						
Recherchiei	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	eleides unter die recherchieren Gebiete	fallen			
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	varme der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)			
C. ALS WE	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN					
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.			
			•			
Υ	"Method of making multilayer pac	ckages by	. 1			
	stamping and laser ablation" IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN	u				
	Bd. 33, Nr. 4, September 1990, Se					
	405-406, XP002090043					
Α	new york siehe das ganze Dokument		5			
^	STETIE das ganze bondinent		,			
Y	BENDER D K ET AL: "HIGHER DENSIT		1			
	DIFFUSION PATTERNED VIAS AND FINE PRINTING"	E-LINE	 			
	IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS,		ı			
	AND MANUFACTURING TECHNOLOGY: PAR		İ			
	Bd. 17, Nr. 3, 1. September 1994, 485-489, XP000462350	, Seiten	i I			
	siehe Abbildung 3		i I			
		,	l			
		-/				
Y Weit	rere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu	X Siehe Anhang Patentfamille				
entne	ehmen	<u> </u>				
"A" Veröffer	ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur	worden ist und mit der			
"E" älteres (icht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	Erfindung zugrundellegenden Prinzips of Theorie angegeben ist				
"L" Veröffer	ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-	"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeu kann allein aufgrund dieser Veröffentlic	hung nicht als neu oder auf			
schein andere	en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden i	erfinderischer Tätigkeit beruhend betrac "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeut				
ausgef	ier die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie führt)	kann nicht als auf erfinderischer Tätigke werden, wenn die Veröffentlichung mit	eit beruhend betrachtet einer oder mehreren anderen			
eine B	ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, ienutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht ntlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach	Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann	naheliegend ist			
dem be	eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben				
Datum des A	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Rec	cherchenberichts			
	4. Januar 1999	28/01/1999				
Name und P	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter				
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Do Pagyo P				
	Fax: (+31-70) 340-3016 De Raeve, R					

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

In: itionales Aktenzeichen
PCT/EP 98/05251

	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	lo-re de la company
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
4	WO 96 09646 A (SIEMENS NV ;IMEC INTER UNI MICRO ELECTR (BE); HEERMAN MARCEL (BE);) 28. März 1996 in der Anmeldung erwähnt siehe Abbildung 1	10
١	US 5 196 089 A (KAMBE ROKURO ET AL) 23. März 1993 siehe Abbildungen 8-10	1
A	US 3 483 308 A (WAKELY WILBUR T) 9. Dezember 1969 siehe Abbildungen 1,3	10

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Int donales Aktenzeichen
PCT/EP 98/05251

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
WO	9609646	A	28-03-1996	EP JP	0782765 A 9511873 T	09-07-1997 25-11-1997
US	5196089	Α	23-03-1993	JP	5013960 A	22-01-1993
US	3483308	Α	09-12-1969	DE FR GB NL	1952569 A 2021493 A 1263126 A 6915455 A	06-05-1970 24-07-1970 09-02-1972 28-04-1970

			-